



AO4806

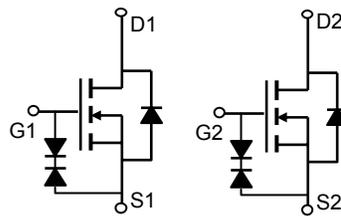
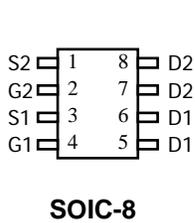
Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

General Description

The AO4806 uses advanced trench technology to provide excellent $R_{DS(ON)}$ and low gate charge. They offer operation over a wide gate drive range from 1.8V to 12V. It is ESD protected. This device is suitable for use as a uni-directional or bi-directional load switch, facilitated by its common-drain configuration.
Standard Product AO4806 is Pb-free (meets ROHS & Sony 259 specifications). AO4806L is a Green Product ordering option. AO4806 and AO4806L are electrically identical.

Features

- V_{DS} (V) = 20V
- I_D = 9.4A (V_{GS} = 10V)
- $R_{DS(ON)} < 14m\Omega$ (V_{GS} = 10V)
- $R_{DS(ON)} < 15m\Omega$ (V_{GS} = 4.5V)
- $R_{DS(ON)} < 21m\Omega$ (V_{GS} = 2.5V)
- $R_{DS(ON)} < 30m\Omega$ (V_{GS} = 1.8V)
- ESD Rating: 2000V HBM



Absolute Maximum Ratings $T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Parameter	Symbol	Maximum	Units
Drain-Source Voltage	V_{DS}	20	V
Gate-Source Voltage	V_{GS}	± 12	V
Continuous Drain Current ^A	I_D	$T_A=25^\circ\text{C}$	9.4
		$T_A=70^\circ\text{C}$	7.5
Pulsed Drain Current ^B	I_{DM}	40	A
Power Dissipation	P_D	$T_A=25^\circ\text{C}$	2
		$T_A=70^\circ\text{C}$	1.28
Junction and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}	-55 to 150	$^\circ\text{C}$

Thermal Characteristics

Parameter	Symbol	Typ	Max	Units
Maximum Junction-to-Ambient ^A	$R_{\theta JA}$	$t \leq 10\text{s}$	45	$^\circ\text{C/W}$
Maximum Junction-to-Ambient ^A		Steady-State	72	$^\circ\text{C/W}$
Maximum Junction-to-Lead ^C	$R_{\theta JL}$	34	40	$^\circ\text{C/W}$

Electrical Characteristics ($T_J=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Units
STATIC PARAMETERS						
BV_{DSS}	Drain-Source Breakdown Voltage	$I_D=250\mu\text{A}$, $V_{GS}=0\text{V}$	20			V
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{DS}=16\text{V}$, $V_{GS}=0\text{V}$ $T_J=55^\circ\text{C}$			10	μA
					25	
I_{GSS}	Gate-Source leakage current	$V_{DS}=0\text{V}$, $V_{GS}=\pm 10\text{V}$			± 10	μA
BV_{GSO}	Gate-Source Breakdown Voltage	$V_{DS}=0\text{V}$, $I_G=\pm 250\mu\text{A}$	± 12			V
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{DS}=V_{GS}$, $I_D=250\mu\text{A}$	0.5	0.75	1	V
$I_{D(ON)}$	On state drain current	$V_{GS}=4.5\text{V}$, $V_{DS}=5\text{V}$	30			A
$R_{DS(ON)}$	Static Drain-Source On-Resistance	$V_{GS}=10\text{V}$, $I_D=9.4\text{A}$ $T_J=125^\circ\text{C}$		11	14	$\text{m}\Omega$
				14.3	17	
		$V_{GS}=4.5\text{V}$, $I_D=8\text{A}$		12.6	16	$\text{m}\Omega$
		$V_{GS}=2.5\text{V}$, $I_D=6\text{A}$		16.5	22	$\text{m}\Omega$
	$V_{GS}=1.8\text{V}$, $I_D=4\text{A}$		23.4	30	$\text{m}\Omega$	
g_{FS}	Forward Transconductance	$V_{DS}=5\text{V}$, $I_D=9.4\text{A}$		37		S
V_{SD}	Diode Forward Voltage	$I_S=1\text{A}$		0.72	1	V
I_S	Maximum Body-Diode Continuous Current				3	A
DYNAMIC PARAMETERS						
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{GS}=0\text{V}$, $V_{DS}=10\text{V}$, $f=1\text{MHz}$		1810		pF
C_{oss}	Output Capacitance			232		pF
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance			200		pF
R_g	Gate resistance	$V_{GS}=0\text{V}$, $V_{DS}=0\text{V}$, $f=1\text{MHz}$		1.6		Ω
SWITCHING PARAMETERS						
Q_g	Total Gate Charge	$V_{GS}=4.5\text{V}$, $V_{DS}=10\text{V}$, $I_D=9.4\text{A}$		17.9		nC
Q_{gs}	Gate Source Charge			1.5		nC
Q_{gd}	Gate Drain Charge			4.7		nC
$t_{D(on)}$	Turn-On Delay Time	$V_{GS}=10\text{V}$, $V_{DS}=10\text{V}$, $R_L=1.1\Omega$, $R_{GEN}=3\Omega$		3.3		ns
t_r	Turn-On Rise Time			5.9		ns
$t_{D(off)}$	Turn-Off Delay Time			44		ns
t_f	Turn-Off Fall Time			7.7		ns
t_{rr}	Body Diode Reverse Recovery Time	$I_F=9.4\text{A}$, $di/dt=100\text{A}/\mu\text{s}$		22		ns
Q_{rr}	Body Diode Reverse Recovery Charge	$I_F=9.4\text{A}$, $di/dt=100\text{A}/\mu\text{s}$		8.6		nC

A: The value of $R_{\theta JA}$ is measured with the device mounted on 1in² FR-4 board with 2oz. Copper, in a still air environment with $T_A=25^\circ\text{C}$. The value in any given application depends on the user's specific board design. The current rating is based on the $t \leq 10\text{s}$ thermal resistance rating.

B: Repetitive rating, pulse width limited by junction temperature.

C. The $R_{\theta JA}$ is the sum of the thermal impedance from junction to lead $R_{\theta JL}$ and lead to ambient.

D. The static characteristics in Figures 1 to 6 are obtained using 80 μs pulses, duty cycle 0.5% max.

E. These tests are performed with the device mounted on 1 in² FR-4 board with 2oz. Copper, in a still air environment with $T_A=25^\circ\text{C}$. The SOA curve provides a single pulse rating.

Rev 3 : Sept 2005

THIS PRODUCT HAS BEEN DESIGNED AND QUALIFIED FOR THE CONSUMER MARKET. APPLICATIONS OR USES AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS ARE NOT AUTHORIZED. AOS DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF SUCH APPLICATIONS OR USES OF ITS PRODUCTS. AOS RESERVES THE RIGHT TO IMPROVE PRODUCT DESIGN, FUNCTIONS AND RELIABILITY WITHOUT NOTICE.

TYPICAL ELECTRICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS

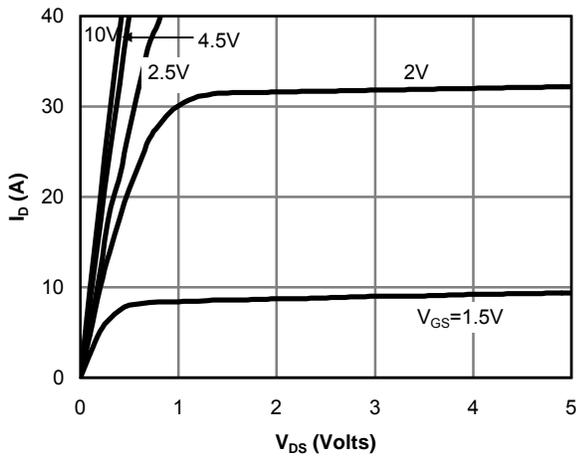


Fig 1: On-Region Characteristics

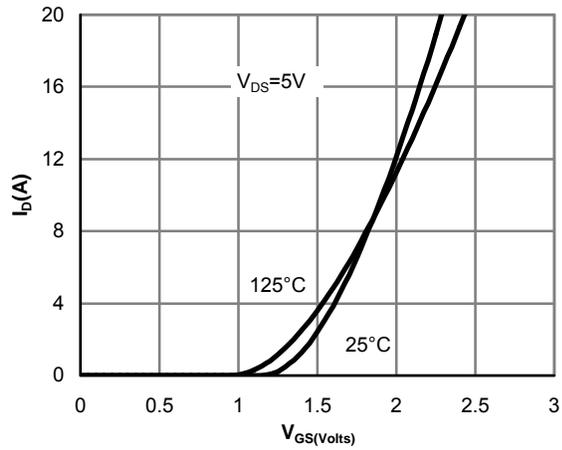


Figure 2: Transfer Characteristics

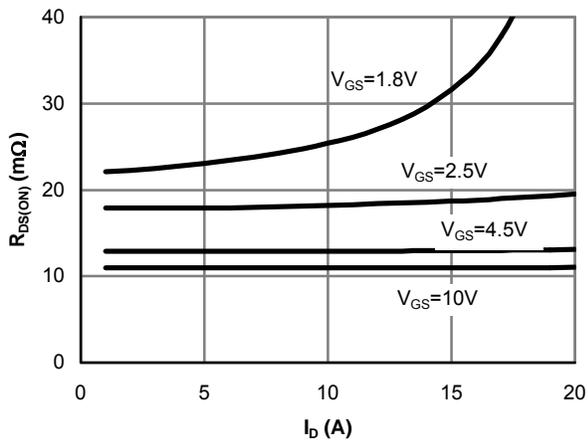


Figure 3: On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage

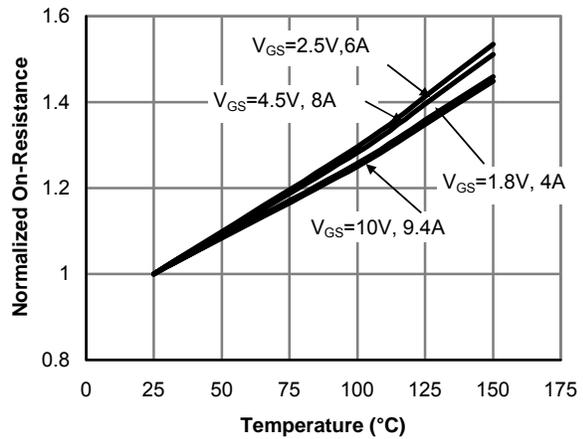


Figure 4: On-Resistance vs. Junction Temperature

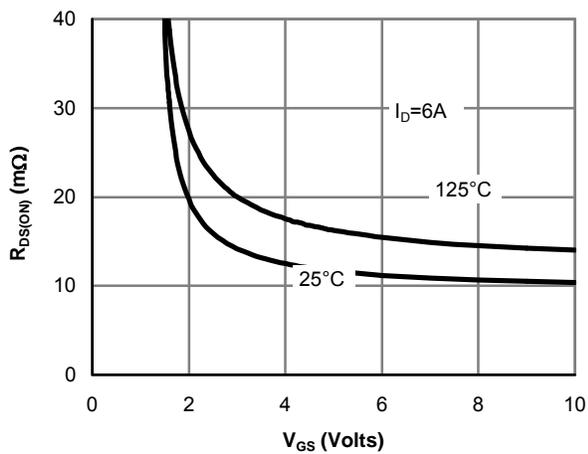


Figure 5: On-Resistance vs. Gate-Source Voltage

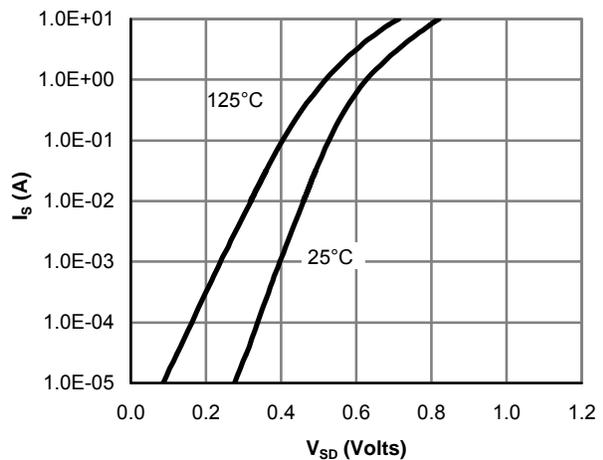


Figure 6: Body-Diode Characteristics

TYPICAL ELECTRICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS

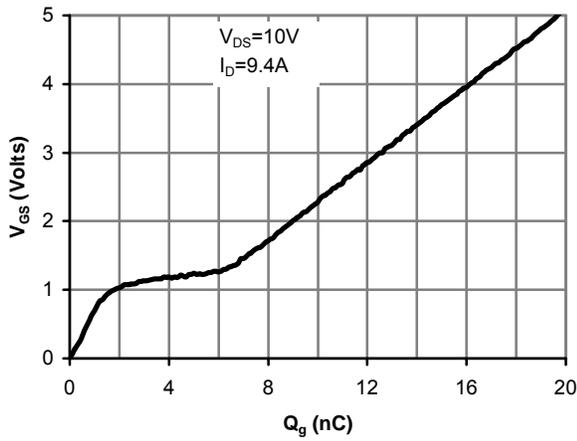


Figure 7: Gate-Charge Characteristics

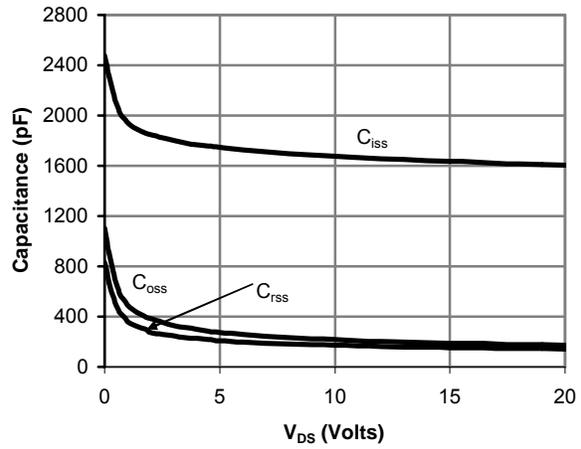


Figure 8: Capacitance Characteristics

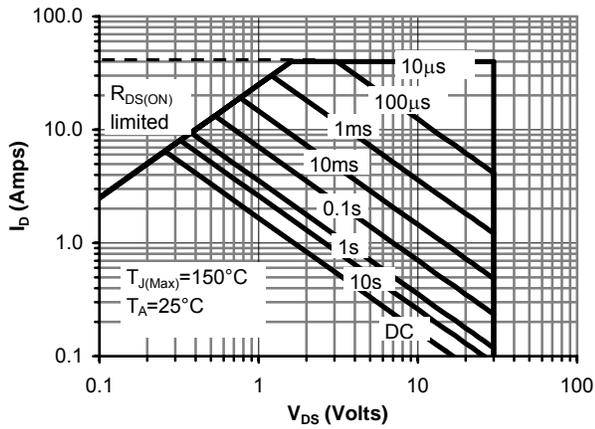


Figure 9: Maximum Forward Biased Safe Operating Area (Note E)

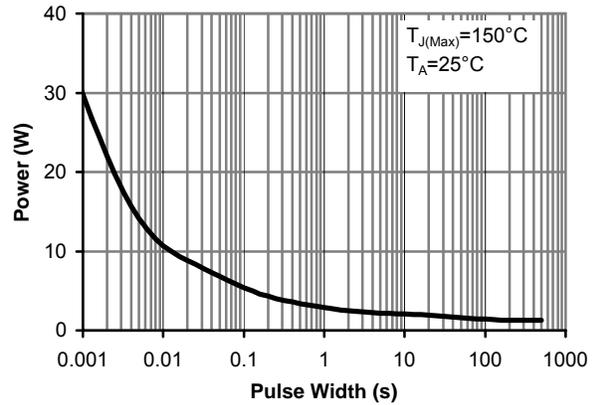


Figure 10: Single Pulse Power Rating Junction-to-Ambient (Note E)

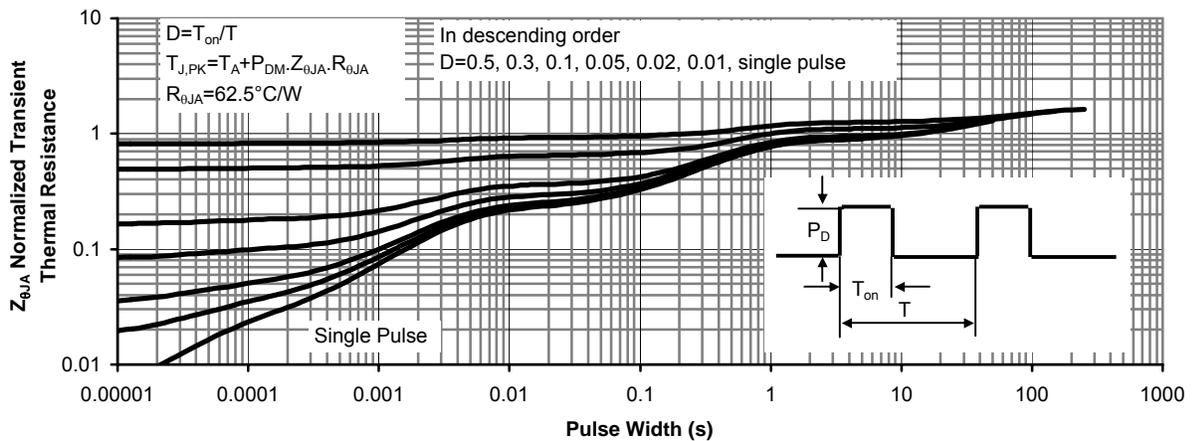


Figure 11: Normalized Maximum Transient Thermal Impedance

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

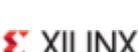
Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>